

Title (en)
WELDING METHOD FOR PRODUCING AN ELECTRICAL CONNECTION

Title (de)
SCHWEISSVERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINER ELEKTRISCHEN VERBINDUNG

Title (fr)
PROCÉDÉ DE SOUDAGE PERMETTANT DE FABRIQUER UN RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

Publication
EP 3664230 A1 20200610 (DE)

Application
EP 19204057 A 20191018

Priority
DE 102018131138 A 20181206

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung einer elektrischen Verbindung zwischen zumindest einer Leitung (13a, 13b) und zumindest einem Anschlussstück (25a, 25b) eines Werkstücks (20). Das Anschlussstück (25a, 25b) ist an einer Werkstückoberfläche (21) angeordnet und ein Ende der zumindest einen Leitung (13a, 13b) ist mit einem an das Anschlussstück (25a, 25b) angepassten Kontaktstück (15a, 15b) vorkonfektioniert. Das Verfahren umfasst die Schritte: Positionieren des Kontaktstücks (15a, 15b) am Anschlussstück (25a, 25b) und Verschweißen des Kontaktstücks (15a, 15b) mit dem Anschlussstück (25a, 25b) mittels Laserstrahlung. Erfindungsgemäß schneidet eine entlang der Laserstrahlung verlaufende Gerade eine durch die Werkstückoberfläche vorgegebene Ebene außerhalb des Werkstücks. Die Erfindung betrifft ferner ein System aus einem Werkstückträger und einem Schweißträger sowie eine Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens.

IPC 8 full level
H01R 43/02 (2006.01)

CPC (source: EP)
H01R 43/0221 (2013.01); **H01R 43/0263** (2013.01)

Citation (search report)
• [XYI] US 7630768 B1 20091208 - COFFED JAMES [US], et al
• [XYI] US 2017110805 A1 20170420 - YOSHIDA TAKUSHI [JP], et al
• [XYI] US 5269056 A 19931214 - YANG ROBERT A [US], et al
• [XY] EP 1306926 A2 20030502 - EIV ENGESER INNOVATIVE VERBIND [DE]
• [Y] US 2010072179 A1 20100325 - DVORAK LEOS [CZ], et al

Designated contracting state (EPC)
AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR

Designated extension state (EPC)
BA ME

DOCDB simple family (publication)
DE 102018131138 B3 20200326; EP 3664230 A1 20200610; EP 3664230 B1 20220817; HU E060427 T2 20230228; PL 3664230 T3 20230313

DOCDB simple family (application)
DE 102018131138 A 20181206; EP 19204057 A 20191018; HU E19204057 A 20191018; PL 19204057 T 20191018